(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210988500 U
(45)授权公告日 2020.07.14

(21)申请号 201921878732.5

(22)申请日 2019.11.02

(73)专利权人 郭牧
地址 430000 湖北省武汉市武昌区八一路2号

(72)发明人 郭牧

(74)专利代理机构 深圳驿航知识产权代理事务所(普通合伙) 44605
代理人 孙小丁

(51)Int.Cl.
A43B 17/02(2006.01)
A43B 17/08(2006.01)
A61H 39/04(2006.01)
A61N 2/08(2006.01)

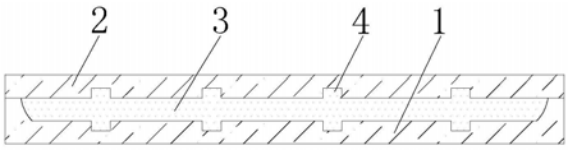
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种鞋垫

(57)摘要

本实用新型提供一种鞋垫，包括底面层，所述底面层的边缘向上延伸形成凸起；上面层，所述上面层设置于所述底面层的上方，与所述底面层相对应；填充物，所述填充物填充于所述底面层与所述上面层之间的缝隙内，所述填充物为非牛顿流体。本实用新型提供的鞋垫分为底面层和上面层，底面层和上面层之间的缝隙内填充非牛顿流体，在不受力时，填充物较为柔软，在受到较大力时，填充物随受力大小逐渐变硬，使得鞋垫整体可以变化，在受力时可以提高鞋垫的结构强度，避免鞋垫损坏，使鞋垫具有一定弹性，可以产生一定的弹性形变，弹性、耐磨性更好。



CN 210988500 U

1.一种鞋垫,其特征在于:包括,

底面层,所述底面层的边缘向上延伸形成凸起;

上面层,所述上面层设置于所述底面层的上方,与所述底面层相对应;

填充物,所述填充物填充于所述底面层与所述上面层之间的缝隙内,所述填充物为非牛顿流体。

2.根据权利要求1所述的鞋垫,其特征在于,所述底面层的上表面和所述上面层的下表面均开设有定位槽。

3.根据权利要求1所述的鞋垫,其特征在于,所述底面层和所述上面层为碳纤维材质。

4.根据权利要求1所述的鞋垫,其特征在于,所述底面层和所述上面层为硅胶材质。

5.根据权利要求1所述的鞋垫,其特征在于,所述底面层和所述上面层为橡胶及其发泡材质。

6.根据权利要求1所述的鞋垫,其特征在于,所述底面层和所述上面层为聚氨酯及其发泡材质。

7.根据权利要求1所述的鞋垫,其特征在于,所述底面层和所述上面层为凝胶材质。

8.根据权利要求1所述的鞋垫,其特征在于,所述上面层的上表面上开设有透气孔。

9.根据权利要求1所述的鞋垫,其特征在于,所述上面层后半部的边缘向上延伸形成凸起的外廓。

10.根据权利要求1所述的鞋垫,其特征在于,所述上面层的内部设置有多个磁石,所述上面层的上表面上设置有多个可对脚掌进行按摩的凸块。

一种鞋垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋垫技术领域，尤其涉及一种鞋垫。

背景技术

[0002] 鞋垫是人们必不可少的生活用品，使用时垫在鞋子内部，鞋垫大量应用于制鞋业、保健、特殊功用；一般分为制鞋业应用型鞋厂应用型鞋垫和市场商品型两种模式。制鞋业应用的鞋垫主要是配合鞋子大底、中底、做出相应的型体；按照楦底板或者面板制作尺码板，并制作出相应的形状。市场商品型鞋垫主要是把鞋垫直接作为一种商品出售，由开发师设计，在市场上流通的产品。

[0003] 现有的鞋垫材质相对比较单一，一般只有单层，在弹性、耐磨性等方便较差，容易损坏、变形，不利用长时间使用，损坏后无法起到对脚掌的保护作用，适应效果不好。

[0004] 因此，有必要提供一种新的鞋垫解决上述技术问题。

发明内容

[0005] 本实用新型提供一种鞋垫，解决的技术问题是现有的鞋垫材质相对比较单一，一般只有单层，在弹性、耐磨性等方便较差，容易损坏、变形，不利用长时间使用。

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的鞋垫，包括底面层，所述底面层的边缘向上延伸形成凸起；上面层，所述上面层设置于所述底面层的上方，与所述底面层相对应；填充物，所述填充物填充于所述底面层与所述上面层之间的缝隙内，所述填充物为非牛顿流体。

[0007] 优选的，所述底面层的上表面和所述上面层的下表面均开设有定位槽。

[0008] 优选的，所述底面层和所述上面层为碳纤维材质。

[0009] 优选的，所述底面层和所述上面层为硅胶材质。

[0010] 优选的，述底面层和所述上面层为橡胶及其发泡材质。

[0011] 优选的，所述底面层和所述上面层为聚氨酯及其发泡材质。

[0012] 优选的，所述底面层和所述上面层为凝胶材质。

[0013] 优选的，所述上面层的上表面上开设有透气孔。

[0014] 优选的，所述上面层后半部的边缘向上延伸形成凸起的外廓。

[0015] 优选的，所述上面层的内部设置有多个磁石，所述上面层的上表面上设置有多个可对脚掌进行按摩的凸块。

[0016] 与相关技术相比较，本实用新型提供的鞋垫具有如下有益效果：

[0017] 本实用新型提供一种鞋垫，分为底面层和上面层，底面层和上面层之间的缝隙内填充非牛顿流体，在不受力时，填充物较为柔软，在受到较大力时，填充物随受力大小逐渐变硬，使得鞋垫整体可以变化，在受力时可以提高鞋垫的结构强度，避免鞋垫损坏，使鞋垫具有一定弹性，可以产生一定的弹性形变，弹性、耐磨性更好，同时使鞋垫具有一定厚度，可以产生增高的效果。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提供的鞋垫的整体的结构示意图；

[0019] 图2为图1所示的鞋垫的侧面剖视图；

[0020] 图3为图1所示的鞋垫的端面的剖视图；

[0021] 图4为图1所示的鞋垫的第二实施例的示意图；

[0022] 图5为图1所示的鞋垫的第三实施例的示意图。

[0023] 图中标号：1、底面层，2、上面层，3、填充物，4、定位槽，5、透气孔，6、外廓，7、底垫，8、凸粒，9、凸块，10、磁石。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0025] 请结合参阅图1、图2和图3，其中，图1为本实用新型提供的鞋垫的整体的结构示意图；图2为图1所示的鞋垫的侧面剖视图；图3为图1所示的鞋垫的端面的剖视图。鞋垫包括：底面层1，所述底面层1的边缘向上延伸形成凸起；上面层2，所述上面层2设置于所述底面层1的上方，与所述底面层1相对应。

[0026] 底面层1和上面层2可为相同材质制成，制作时，将上面层2连接在底面层1外边缘的凸起部分上，在底面层1与上面层2之间形成缝隙。

[0027] 所述底面层1和所述上面层2为碳纤维材质。

[0028] 所述底面层1和所述上面层2还可以为硅胶材质、橡胶及其发泡材质、聚氨酯及其发泡材质、凝胶材质或者其他材质。

[0029] 填充物3，所述填充物3填充于所述底面层1与所述上面层2之间的缝隙内，所述填充物3为非牛顿流体。

[0030] 在不受力时，填充物3较为柔软，在受到较大力时，填充物3随受力大小逐渐变硬，使得鞋垫整体可以变化，在受力时可以提高鞋垫的结构强度，避免鞋垫损坏，使鞋垫具有一定弹性，可以产生一定的弹性形变，弹性、耐磨性更好。

[0031] 所述底面层1的上表面和所述上面层2的下表面均开设有定位槽4。填充物3流入定位槽4内，使得成型后的填充物3与底面层1和上面层2相对固定，提高底面层1、填充物3和上面层3的整体性，不会产生相对位移导致脚滑。

[0032] 所述上面层1的上表面上开设有透气孔5，使用时更加透气，不会闷脚。

[0033] 所述上面层1后半部的边缘向上延伸形成凸起的外廓6，在鞋垫的外边缘形成保护圈，对脚掌侧面进行保护。

[0034] 第二实施例

[0035] 如图4所示，基于本申请的第一实施例提供的鞋垫，本申请的第二实施例提出另一种鞋垫。第二实施例仅仅是第一实施例优选的方式，第二实施例的实施对第一实施例的单独实施不会造成影响。

[0036] 具体的，底面层1的底面的前端和后端处于脚掌和脚跟受力的位置分别设置有底垫7，底垫7可以为PU材质，具有弹性好、耐用性强的优点，提高受力点的耐磨性，同时可以提升脚底触感，在底面层1底面的中部设置有凸起的凸粒8，提高与鞋子间的接触效果，增大摩擦力避免滑动。

[0037] 本实用新型提供的鞋垫的工作原理如下：

[0038] 将上面层2设置在底面层1的上方，在底面层1和上面层2之间的缝隙内填充非牛顿流体，在不受力时，填充物3较为柔软，在受到较大力时，填充物3随受力大小逐渐变硬，使得鞋垫整体可以变化，在受力时可以提高鞋垫的结构强度，避免鞋垫损坏，使鞋垫具有一定弹性，可以产生一定的弹性形变，弹性、耐磨性更好。

[0039] 第三实施例

[0040] 如图5所示，基于本申请的第一实施例提供的鞋垫，本申请的第三实施例提出另一种鞋垫。第三实施例仅仅是第一实施例优选的方式，第三实施例的实施对第一实施例的单独实施不会造成影响。

[0041] 具体的，所述上面层2的内部设置有多个磁石10，所述上面层2的上表面上设置有多个可对脚掌进行按摩的凸块9，凸块9可以与脚掌底部接触进行按摩，磁石10可以刺激足底穴位和神经，起到促进足底血液循环，缓解疲劳的效果。

[0042] 与相关技术相比较，本实用新型提供的鞋垫具有如下有益效果：

[0043] 本实用新型提供一种鞋垫，分为底面层1和上面层2，底面层1和上面层2之间的缝隙内填充非牛顿流体，在不受力时，填充物3较为柔软，在受到较大力时，填充物3随受力大小逐渐变硬，使得鞋垫整体可以变化，在受力时可以提高鞋垫的结构强度，避免鞋垫损坏，使鞋垫具有一定弹性，可以产生一定的弹性形变，弹性、耐磨性更好。

[0044] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

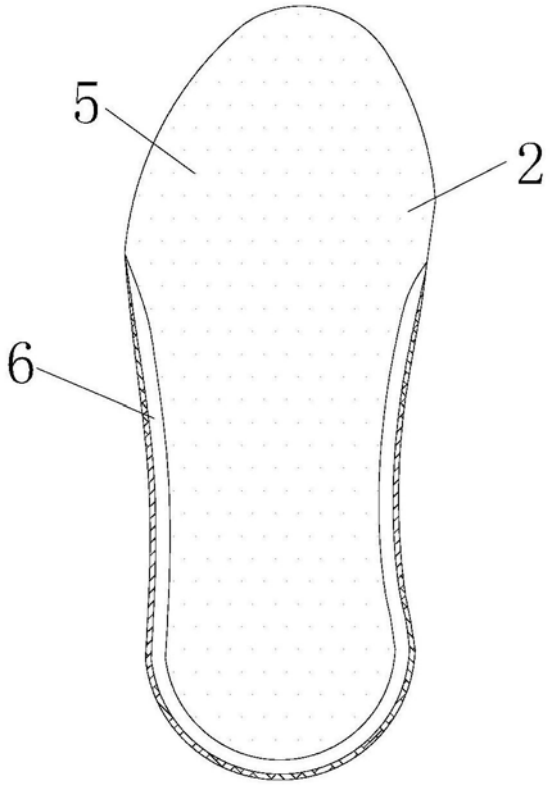


图1

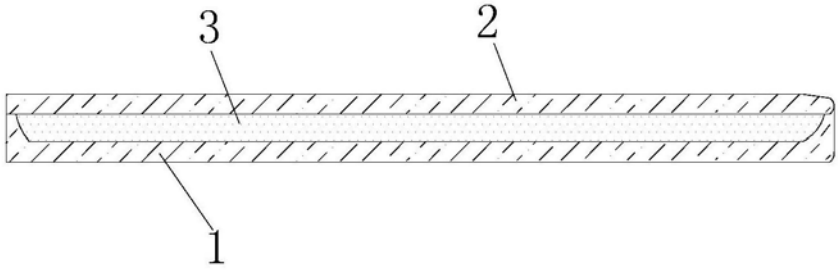


图2

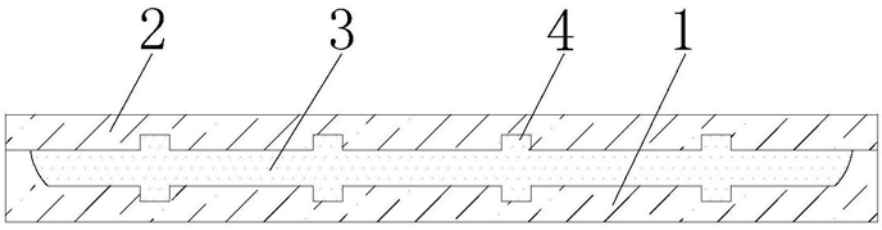


图3

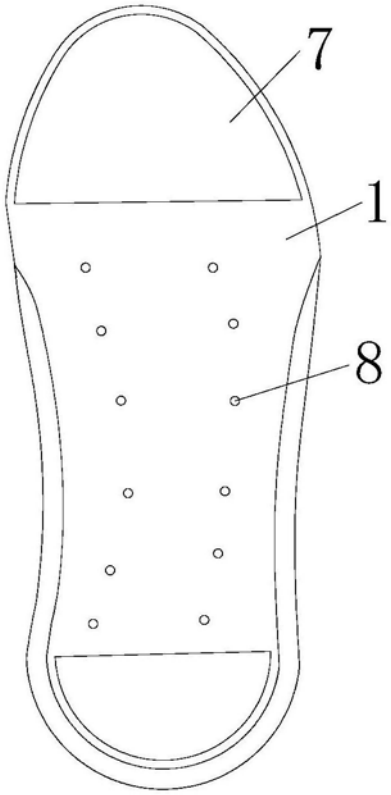


图4

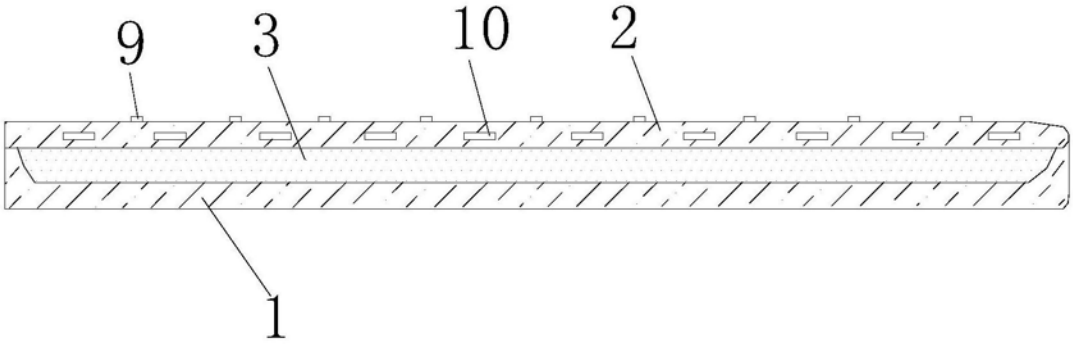


图5